

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-044

苏州卓兆点胶股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 5 月 16 日 15:00-17:00

活动地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）网络互动平台

参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈晓峰先生；公司董事会秘书：谢凌志先生；公司财务总监：黄春杰女士；公司保荐代表人：曹飞先生。

三、投资者关系活动主要内容

公司在 2024 年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：报告期内公司主营业务收入依赖点胶设备、点胶阀及核心部件销售，

面对行业竞争加剧，未来是否有拓展新应用领域的计划？

回答：尊敬的投资者您好，公司有拓展新应用领域的计划。为高效推进核心业务与新兴业务协同发展，公司以“专业专注、协同共享”为原则，优化组织架构设计，构建适应双轮驱动的资源配置机制。依托公司在点胶设备领域的技术优势、客户资源和丰富经验，积极拓展新产品的应用领域。在巩固智能点胶设备核心业务的基础上，重点关注视觉检测、直线电驱等领域的发展机遇。通过市场调研、技术研发、产品推广等手段，逐步将公司的产品和服务推向新的应用领域，开辟新的业务增长点。

2025 年，公司将纵向深耕高端应用场景，以流体控制技术为核心，开发专用设备适配四大高增长领域：半导体封装、光伏组件高粘度密封、新能源汽车（汽车电子、动力电池），实现从消费电子到半导体、新能源、光伏等高端市场的全覆盖；横向丰富差异化产品矩阵，拓展喷射阀、螺杆阀、柱塞阀等点胶阀产品线，覆盖从微纳级精密涂覆到超大流量材料控制的工艺需求，适配低粘度到高粘度等不同性质流体的涂覆与控制需求，满足不同场景的精细化流体控制需求。

同时，公司积极开拓非果链高端市场，优化收入结构，重点提升新能源汽车、光伏、半导体等非消费电子领域占比，同步拓展视觉检测、直线电驱等新兴业务板块，构建多元化客户结构与业务增长点。感谢您对公司的关注。

问题 2：公司提到直接向苹果公司及知名 EMS 厂商供货，能否介绍苹果供应链订单在 2024 年的占比变化？

回答：尊敬的投资者您好，2024 年度，公司向苹果公司及其 EMS 厂商、设备集成商的销售收入占当期营业收入的比例不到 80%，相较上一年度对苹果产业链依赖的风险有所降低。感谢您对公司的关注。

问题 3：公司之后有什么经营规划？

回答：尊敬的投资者您好，公司将深耕苹果产业链，依托 iPad、耳机等现有供应基础，提升在苹果手机、手表、MR 设备及电池组件领域的份额，并切入相关检测设备市场，深化多品类、多场景的合作渗透。积极开拓非果链高端市场，优化收入结构，重点提升新能源汽车、光伏、半导体等非消费电子领域占比，同步拓展视觉检测、直线电驱等新兴业务板块，构建多元化客户结构与业务增长点。感谢您对公司的关注。

问题 4：行业以后的发展前景怎么样？

回答：尊敬的投资者您好，智能点胶设备行业发展前景较为广阔。从行业趋势来看，其作为智能制造装备细分领域，受益于我国电子信息制造业快速发展，国产智能装备向高附加值产业链迈进，终端产品更新迭代快，下游市场需求旺盛。据国际半导体产业协会（SEMI）及相关资料，预计到 2028 年全球点胶机行业市场规模将达 106.8 亿美元；头豹研究院数据显示，2025 年中国精密流体控制设备市场规模预计达到 490.6 亿元。

从下游领域来看，消费电子领域虽部分产品景气度下滑，但保有量基数高、更新迭代空间大，可穿戴设备发展势头强劲；新能源汽车领域在政策支持下发展迅速，预计到 2025 年我国新能源汽车市场渗透率有望达 30%，销量将达 1150 万辆，汽车电子市场规模也将扩大，动力电池需求随之增长；光伏领域国内外新增装机容量增加带动组件需求和产量上升，《中国 2050 年光伏发展展望》预计到 2035 年我国光伏发电总装机规模将达 3000GW；半导体领域我国集成电路产量增长，国际半导体产业协会（SEMI）预测到 2025 年全球半导体制造设备市场规模将攀升至 1460 亿美元。

此外，国家出台产业扶持政策，如《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中国制造 2025》等，为半导体产业及半导体点胶设备行业提供了发展动力。感谢您对公司的关注。

问题 5：公司后续如何进行市值管理？公司控股股东是否有减持计划？

回答：尊敬的投资者您好，市场股价波动受多重因素影响，我们将按照市值管理制度相关规定合规合法地做好市值管理工作，持续全力保持产品技术和服务优势，促进公司实现高质量发展，更好地回报股东、回馈社会。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股票目前尚处于限售状态，未来解除限售及减持（如有）均将按照相关法律法规进行公告披露，请您以公司公告信息为准。感谢您对公司的关注。

问题 6：公司于 2024 年收购广东浦森，请问标的公司什么时候并表的？一季度经营情况怎么样？

回答：尊敬的投资者您好，公司并购标的广东浦森塑胶科技有限公司已于 2025 年 2 月起并表，广东浦森一季度经营情况稳定，后续经营情况请关注公司

定期报告。感谢您对公司的关注。

问题 7：面对半导体封装等高精度点胶场景的需求增长，公司产品是否已具备相应技术储备？何时能实现规模化销售？

回答：尊敬的投资者您好，半导体制造的工艺过程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、芯片测试所组成，点胶工艺在半导体封装环节起到了不可或缺的作用。芯片封装系将芯片用胶粘剂贴装到封装基板上进行固定，引出接线端子并通过可塑性绝缘介质灌封，达到固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用。

随着电子器件朝微型化、精密化方向发展，点胶工艺在芯片封装中的精密化程度提升，无接触式喷射点胶的出现，大大提高了流体材料分配的速度，喷射频率高，并且胶点均匀、一致性好，可实现在非常紧凑的区域、异型点胶区域完成点胶操作，公司高精度喷射阀、喷雾阀可针对单个高精元件的遮蔽防护、实现多角度全方位的涂覆。

公司已在半导体封装领域有部分应用案例，但何时能实现规模化销售仍具有不确定性。感谢您对公司的关注。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日